

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Datenblatt gilt auch für TD W3H

Datasheet also applicable for TD W3H

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1200, 1400 1600, 1800	V V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{DSM}	1200, 1400 1600, 1800	V V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RSM}	1300, 1500 1700, 1900	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert (pro Element) RMS on-state current (per chip)		I_{TRMSM}	100	A
Effektivstrom (pro Phase) RMS current (per arm)	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 73^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{A}} = 45^{\circ}\text{C}, \text{KM } 11$ $T_{\text{A}} = 45^{\circ}\text{C}, \text{KM } 33$ $T_{\text{A}} = 35^{\circ}\text{C}, \text{KM } 14 (V_{\text{L}} = 45\text{V/s})$ $T_{\text{A}} = 35^{\circ}\text{C}, \text{KM } 33 (V_{\text{L}} = 90\text{V/s})$	I_{RMS}	115 141 38 55 97 115	A A A A A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I_{TSM}	1000 870	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	5000 3780	A^2s A^2s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{\text{cr}}$	120	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 8. Kennbuchstabe / 8th letter F	$(dv/dt)_{\text{cr}}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_{\text{T}} = 150\text{A}$	V_{T}	max. 1,81	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(\text{T0})}$	0,95	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_{T}	4,3	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$	I_{GT}	max. 150	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$	V_{GT}	max. 2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	I_{GD}	max. 5,0 max. 2,5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max. 0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{A}} = 5\Omega$	I_{H}	max. 200	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 20\Omega$ $i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}, t_{\text{G}} = 10\mu\text{s}$	I_{L}	max. 600	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max. 10	mA
Zündverzögerung gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 0,6\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 1,2	μs

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $i_{TM} = 50A$ $V_{RM} = 100V$, $V_{DM} = 0,67 V_{ORM}$ $dV_D/dt = 20V/\mu s$, $-di_T/dt = 10A/\mu s$ 7. Kennbuchstabe / 7th letter O	t_q	typ. 190	μs
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50Hz$, $t = 1min$ RMS, $f = 50Hz$, $t = 1sec$	V_{ISOL}	3,0 3,6	kV kV

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ\sin$ pro Element / per chip, $\Theta = 180^\circ\sin$ pro Modul / per module, DC pro Element / per chip, DC	R_{thJC}	max. 0,083 max. 0,500 max. 0,078 max. 0,470	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module pro Element / per chip	R_{thCK}	max. 0,033 max. 0,200	$^\circ C/W$ $^\circ C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\max}$	125	$^\circ C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$	- 40...+125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	- 40...+130	$^\circ C$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

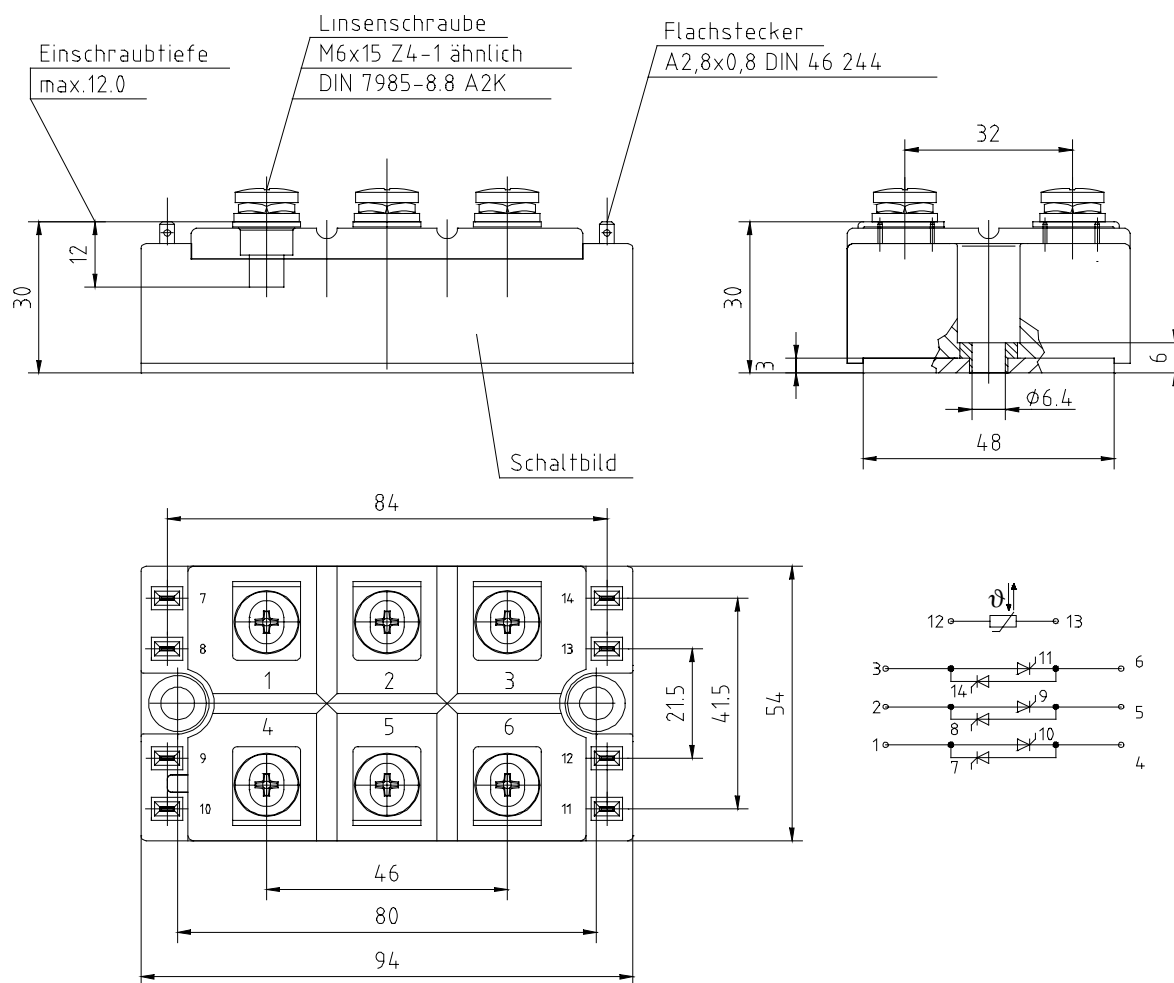
Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Elemente mit Lötkontakt, glaspassiviert Si-pellets with soldered contact, glass-passivated				
Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance $+5\%$ / -10%	M2	6	Nm
Gewicht weight		G	typ. 300	g
Kriechstrecke creepage distance			12,5	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50Hz$		50	m/s^2

Temperatursensor / Temperature sensor

Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ C$ $R_{100} = 493\Omega \pm 5\%$	R_{25}	5	$k\Omega$
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	P_{25}	max. 20	mW

Kühlkörper / heatsinks : KM 11; KM 14; KM 17; KM 33

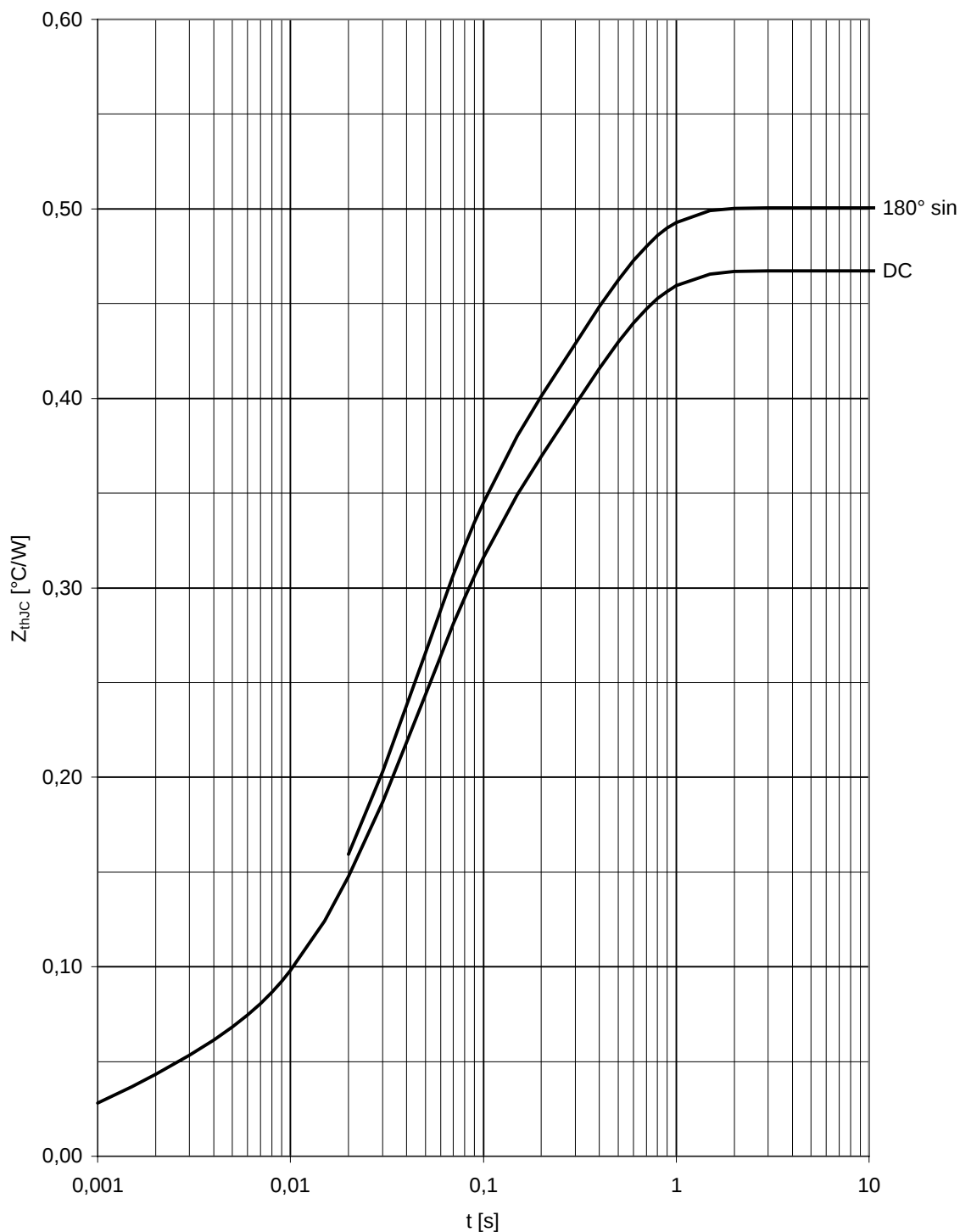
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



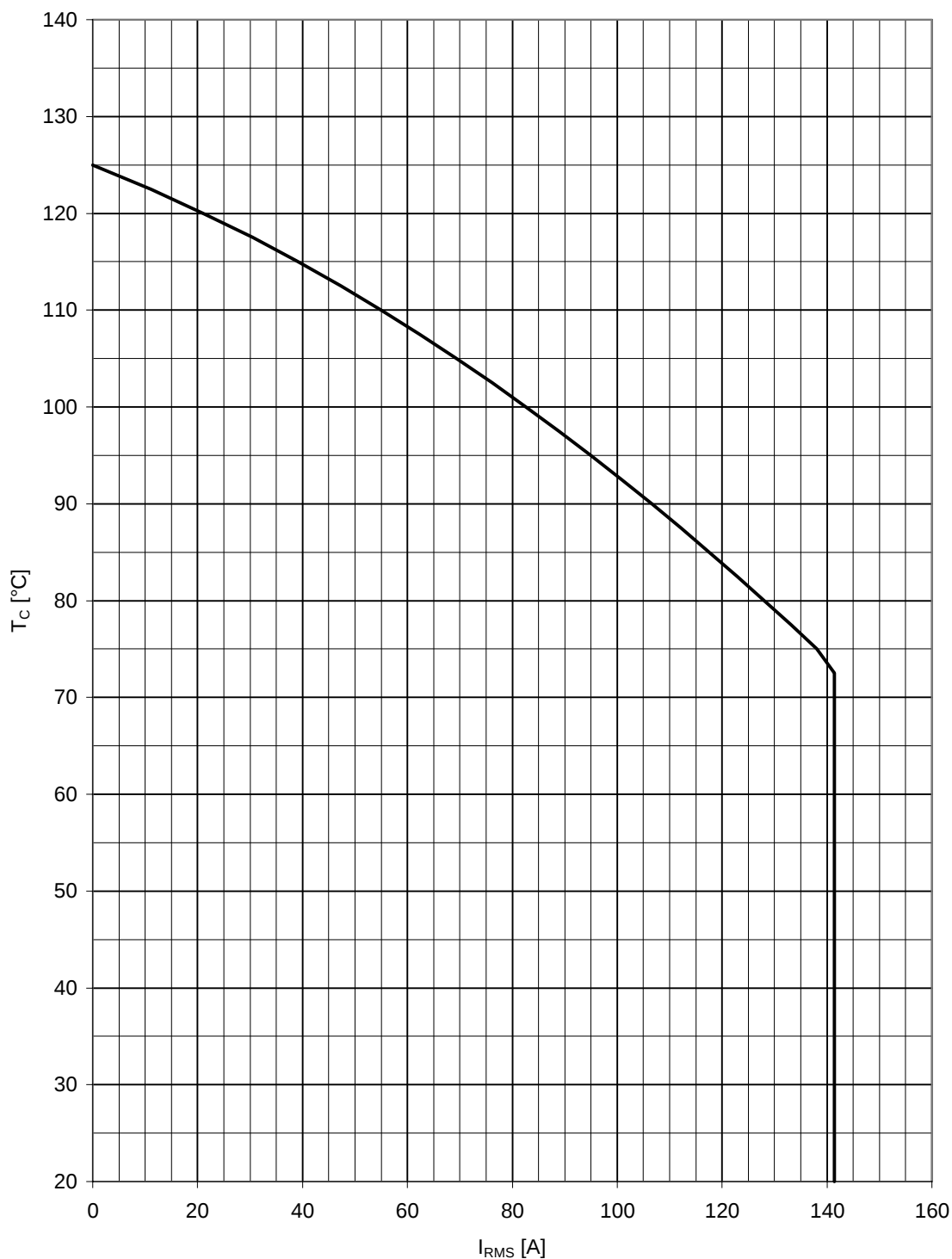
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DCAnalytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}\text{C} / \text{W}]$	0,18100	0,25100	0,03520				
$\tau_n [\text{s}]$	0,31800	0,03870	0,00109				

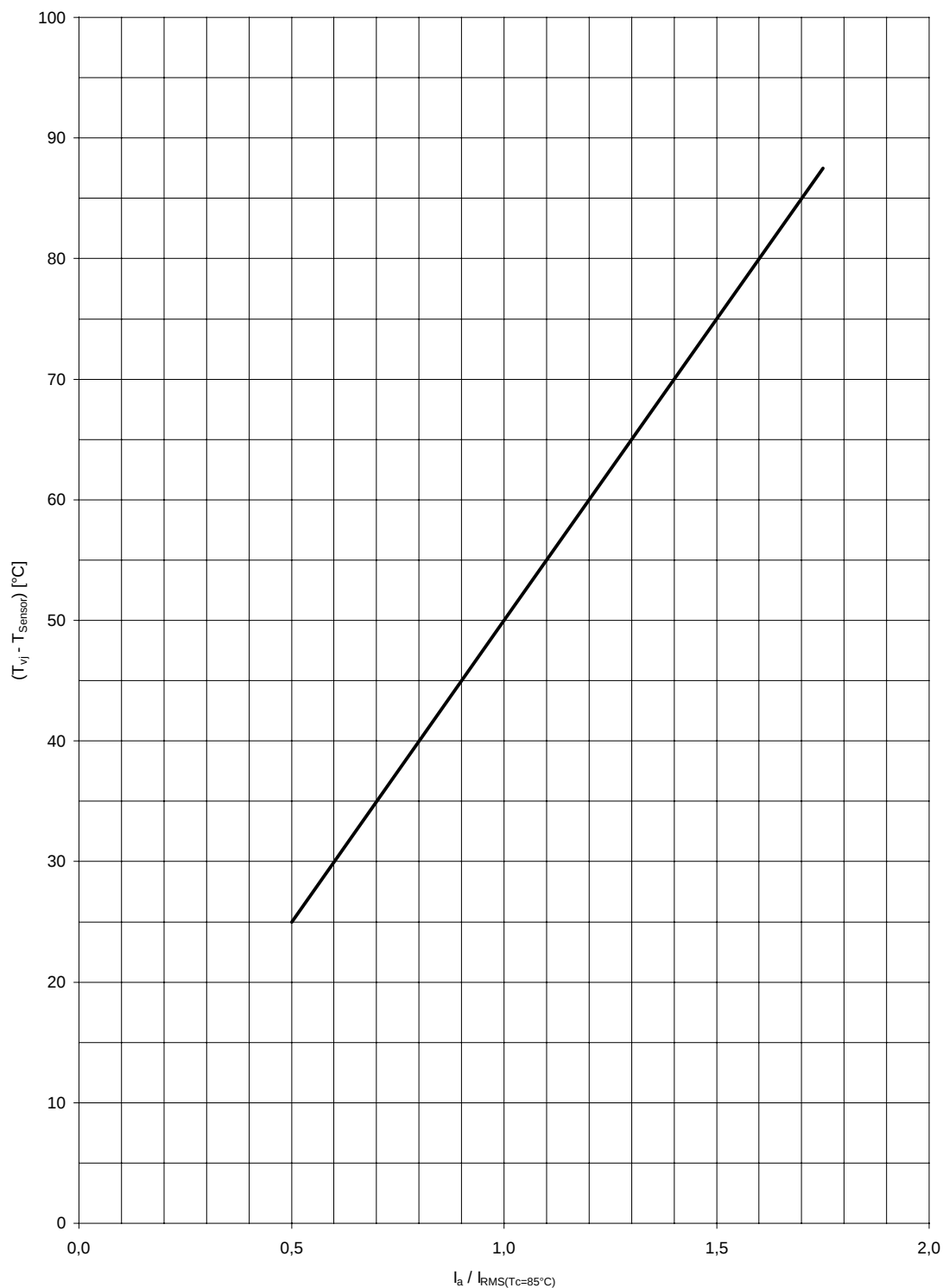
Analytische Funktion:
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{\infty} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm, $Z_{thJC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ



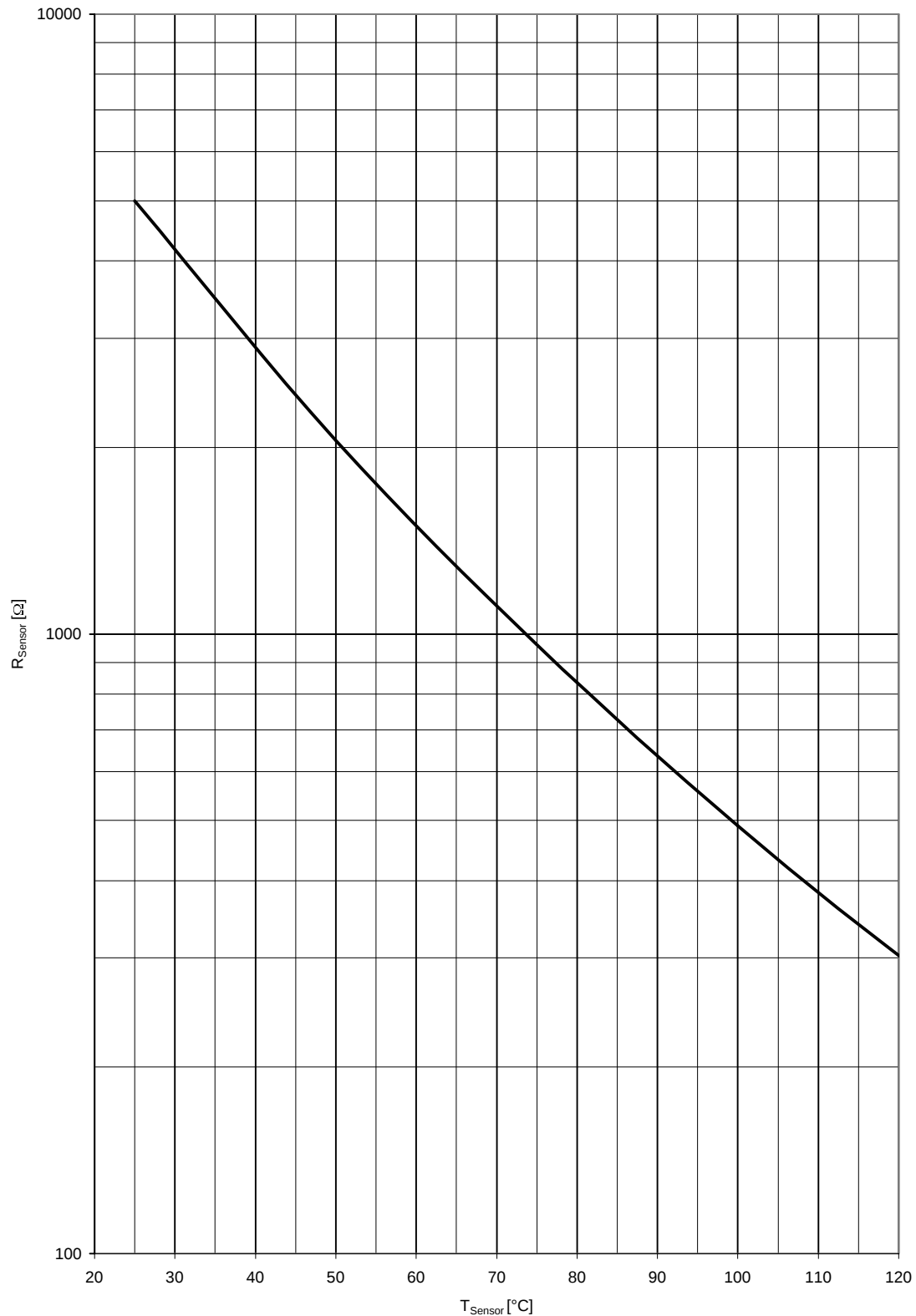
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{RMS})$



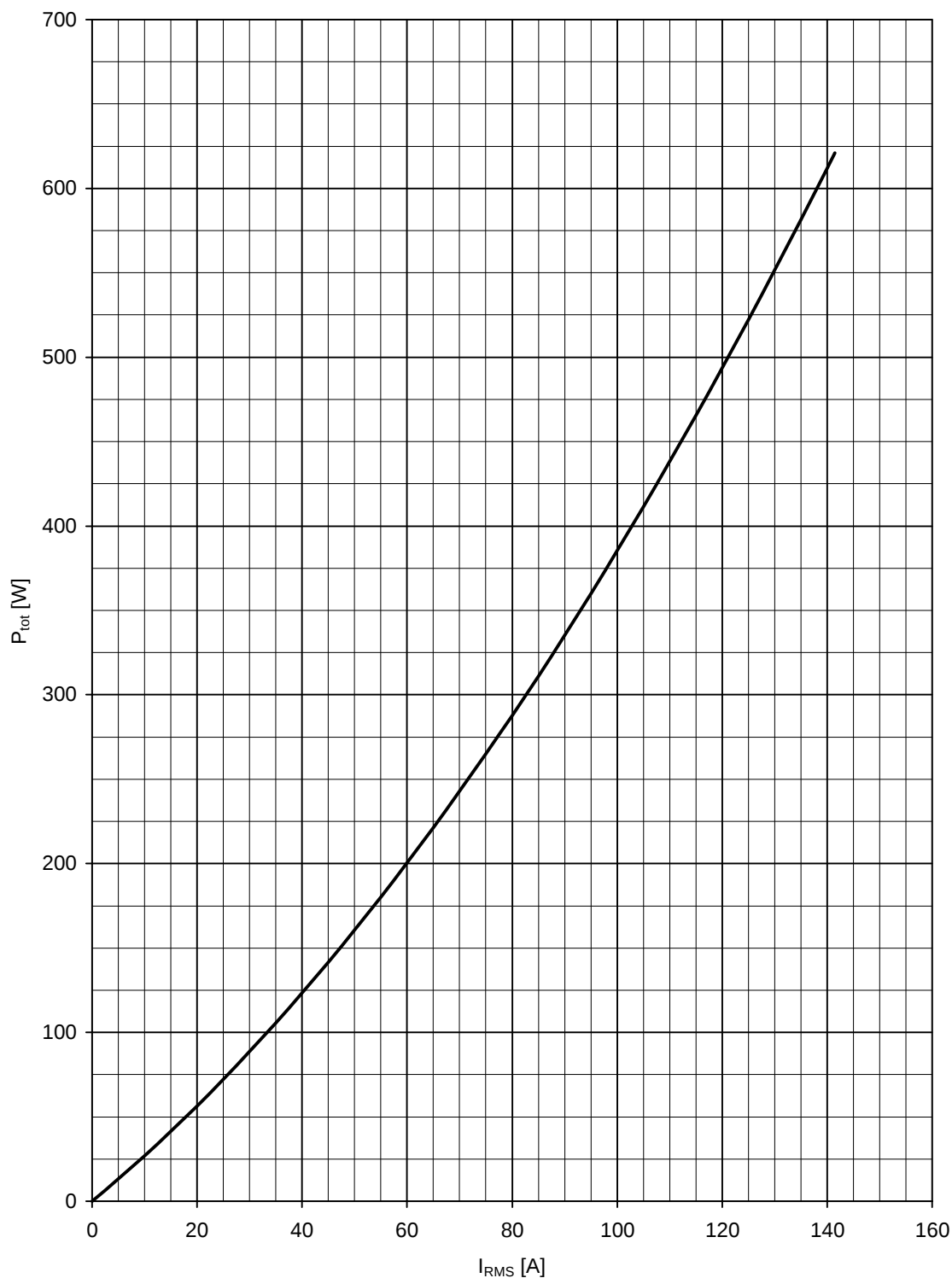
Differenz zwischen Sperrschicht- und Sensortemperatur / Difference between the values of junction and sensor temperature $(T_j - T_{Sensor}) = f(I_a / I_{RMS(T_c=85^\circ C)})$

I_a : Anlaufstrom / Starting current

I_{RMS} : Effektivstrom (pro Phase) / RMS current (per arm)



Sensorwiderstand / Sensor resistance $R_{\text{Sensor}} = f(T_{\text{Sensor}})$

Gesamtverlustleistung pro Modul / Total power dissipation per module $P_{\text{tot}} = f(I_{\text{RMS}})$ I_{RMS} : Effektivstrom (pro Phase) / RMS current (per arm)